



FATC 記憶體最佳代工夥伴

福懋科技 2023年法人說明會

總經理暨發言人 張憲正

2023年5月26日

免責聲明

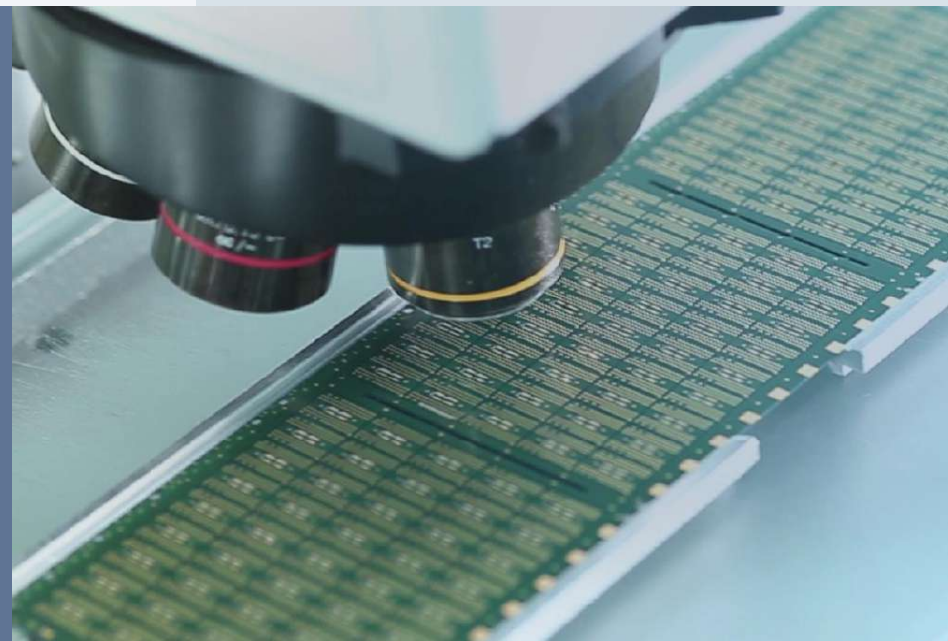
簡報內容（含本會議中所揭露之資訊）含有若干預測性資訊，僅供參考之用。福懋科技股份有限公司或任何第三人均不就該預測性資訊之正確性與完整性承擔任何責任，亦不負更新或更正該資訊之義務，請您務必謹慎審閱以上資訊。如未經許可，亦請您切勿散播、重製或揭露以上資訊之一部分或全部予第三人。

會議議程

- 1 2023年第一季營運績效及財務狀況
- 2 研究發展規劃
- 3 營運重點與市場展望
- 4 問與答

1

2023年第一季 營運績效及財務狀況



2023年第1季財務摘要

單位:新台幣仟元

項 目	2023年第1季		2022年第4季		較上季差異		2022年第1季		較去年同期差異	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
會計科目										
營業收入	2,169,797	100.0	2,500,939	100.0	-331,142	-13.2	2,562,634	100.0	-392,837	-15.3
營業毛利	335,744	15.5	509,517	20.4	-173,773	-34.1	514,189	20.1	-178,445	-34.7
營業利益	277,690	12.8	443,970	17.8	-166,280	-37.5	449,585	17.5	-171,895	-38.2
稅前息前折舊攤銷前利益	593,427	27.3	661,990	26.5	-68,563	-10.4	903,437	35.3	-310,010	-34.3
稅前淨利	289,491	13.3	352,533	14.1	-63,042	-17.9	576,424	22.5	-286,933	-49.8
本期淨利	231,593	10.7	282,026	11.3	-50,433	-17.9	461,139	18.0	-229,546	-49.8
每股盈餘(元/股)	0.52		0.64		-0.12		1.04		-0.52	
每股淨值(元/股)	26.29		28.74		-2.45		28.74		-2.45	

2023年第1季綜合損益表

單位:新台幣仟元

項 目	2023年第1季		2022年第4季		較上季差異		2022年第1季		較去年同期差異	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
會計科目										
營業收入	2,169,797	100.0	2,500,939	100.0	-331,142	-13.2	2,562,634	100.0	-392,837	-15.3
營業毛利	335,744	15.5	509,517	20.4	-173,773	-34.1	514,189	20.1	-178,445	-34.7
營業利益	277,690	12.8	443,970	17.8	-166,280	-37.5	449,585	17.5	-171,895	-38.2
業外收入(支出)	11,801	0.5	-91,437	-3.66	103,238	-	126,839	4.9	-115,038	-90.7
稅前淨利	289,491	13.3	352,533	14.1	-63,042	-17.9	576,424	22.5	-286,933	-49.8
本期淨利	231,593	10.7	282,026	11.3	-50,433	-17.9	461,139	18.0	-229,546	-49.8
每股盈餘(元/股)	0.52		0.64		-0.12		1.04		-0.52	
每股淨值(元/股)	26.29		28.74		-2.45		28.74		-2.45	

2023年第1季與2022年第4季差異說明

單位:新台幣仟元

項目	2023年Q1		2022年Q4		差異		差異說明
	金額	%	金額	%	金額	%	
會計科目							
營業收入	2,169,797	100.0	2,500,939	100.0	-331,142	-13.2	銷售量季減高十位數百分比，平均代工單價季減低十位數百分比，匯率影響不利低個位數百分比。
營業毛利	335,744	15.5	509,517	20.4	-173,773	-34.1	2023年Q1毛利季減34.1%，主要係銷售量減少、代工單價降低。
營業利益	277,690	12.8	443,970	17.8	-166,280	-37.5	2023年Q1營業利益季減166,280仟元，主要為毛利減少173,773仟元、推銷管理費用減少4,257仟元及研發費用減少3,236仟元。
本期淨利	231,593	10.7	282,026	11.3	-50,433	-17.9	本期淨利季減50,433仟元，主要為營業利益減少166,280仟元、利息收入增加19,222仟元、兌換損失減少114,348仟元、其他收入減少24,551仟元及所得稅費用減少12,609仟元。

現金流量表

2023年第1季現金流量

單位:新台幣仟元

2023年Q1

期初餘額

5,158,474

營業活動之現金流量

703,777

資本支出

-181,660

金融資產及其他

-256,759

期末餘額

5,423,832

自由現金流量

522,117

營業活動之現金流量

703,777

資本支出

-181,660

金融資產其他

-256,759

5,158,474

2023/1/1
期初餘額

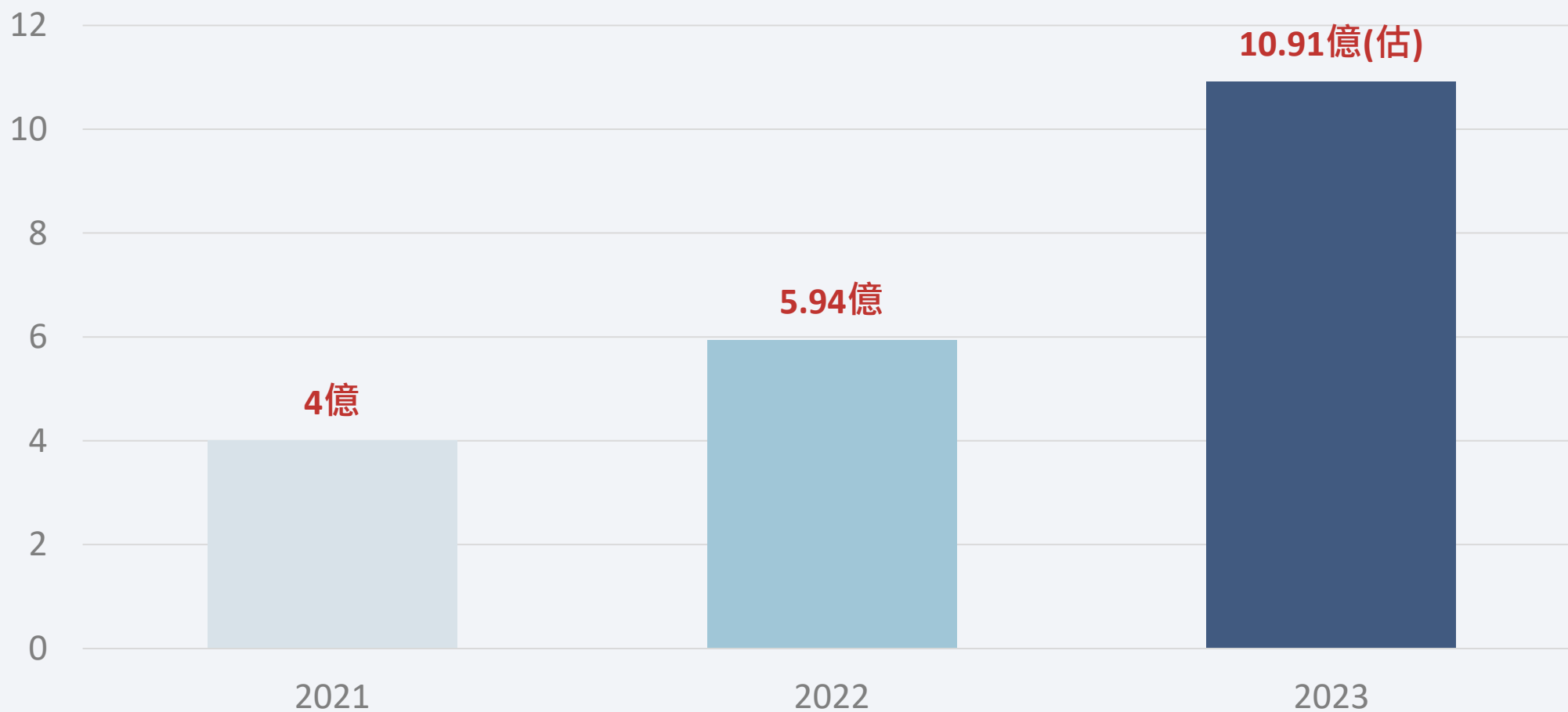
5,423,832

2023/3/31
期末餘額

2023年第一季自由現金流量為522,117仟元

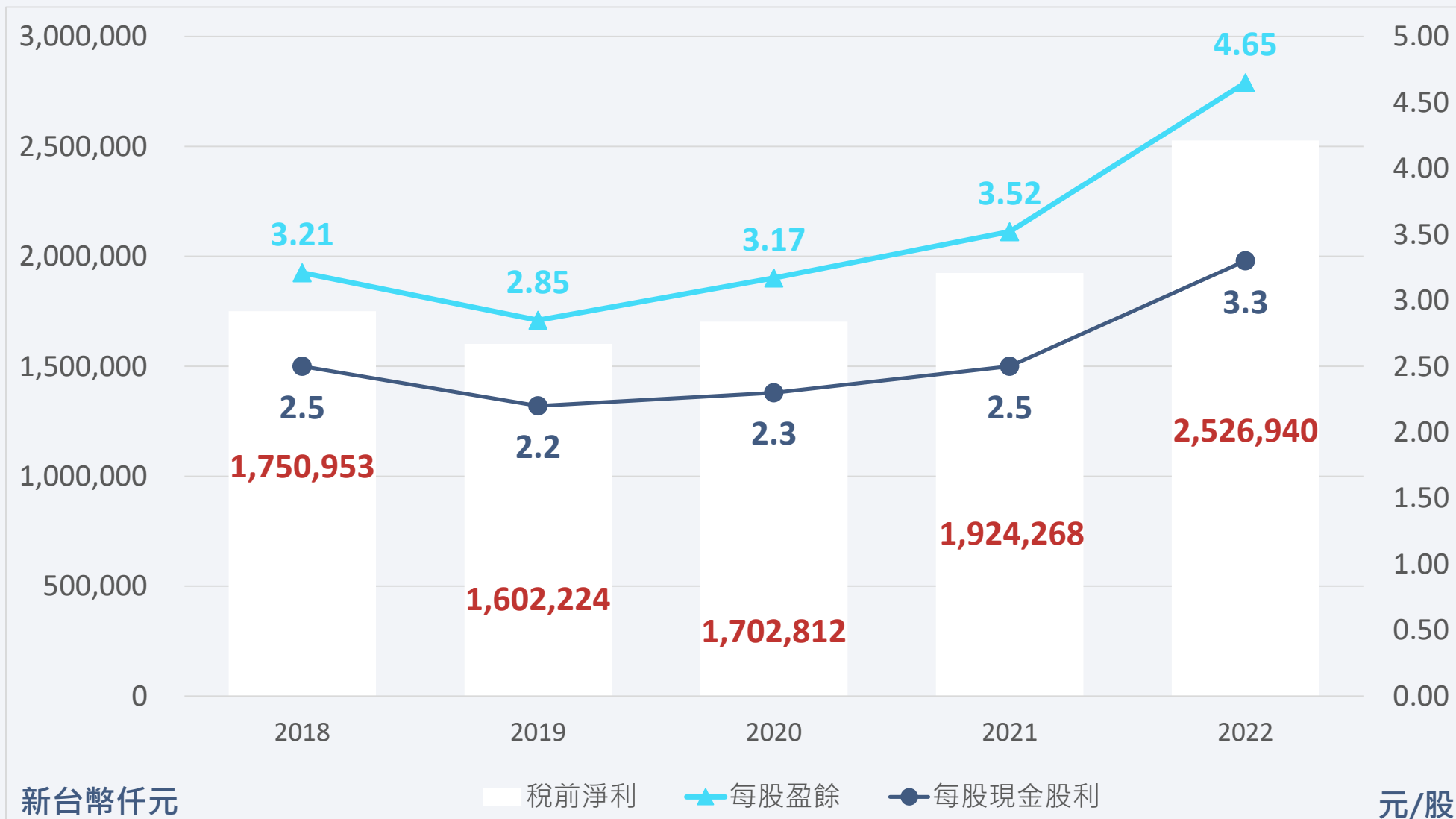
歷年資本支出

單位:新台幣億元

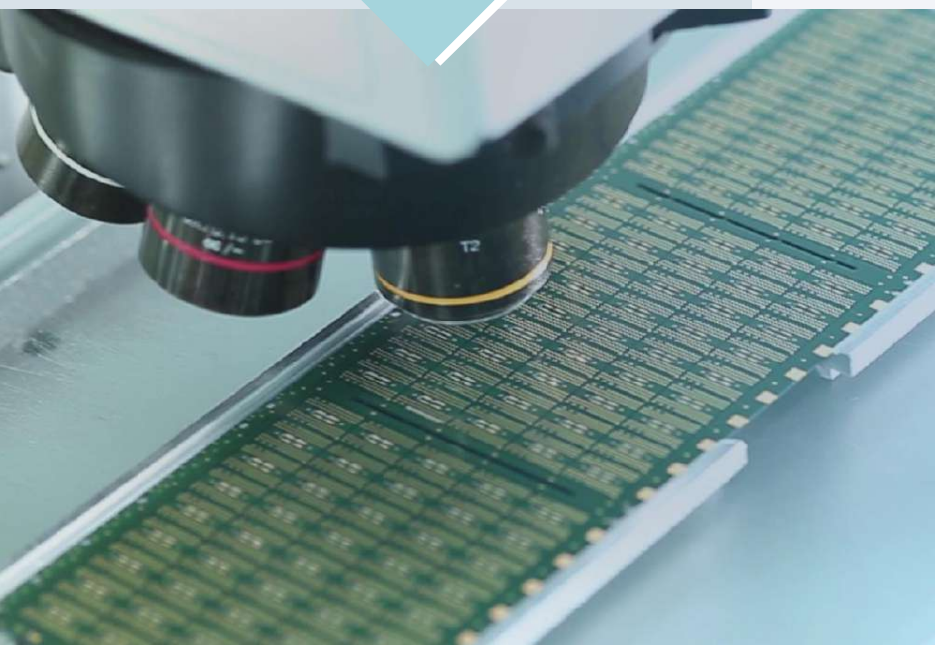


近5年之稅前淨利、稅後EPS、現金股利

單位:新台幣仟元



2



研究發展 與規劃

研究發展與規劃

在全球記憶體庫存偏高，終端產品需求趨緩的不利環境下，福懋科技持續開發新產品/新技術以累積未來成長的動能。

1

專注DDR5新世代產品開發，目前已完成10奈米級第一世代DDR5覆晶封裝和高速測試產品驗證。

2

因應未來高速度/高頻寬的記憶體產品需求，將開發晶圓凸塊(Bumping)及覆晶(Flip Chip)封裝技術。

3

營運重點與 市場展望



營運重點

1

受通膨、升息與俄烏戰爭影響，上半年全球經濟景氣不佳，終端產品需求減少，庫存水位仍待去化。

2

客戶調節晶圓產出導致封測代工需求下降；
電競產品與伺服器模組需求放緩並要求縮短交期；
因應個別客戶需求，將彈性調配產能以滿足客戶交期。

3

短期需求不佳，但DRAM在電子產品的應用廣泛，
在汽車、物聯網、AI、5G、VR的需求將使產業保持成長動能。
公司將持續佈局新世代DDR5產品，新廠的擴建亦持續進行。

市場展望

1 全球經濟景氣負面因素逐步趨緩，預期下半年伺服器模組、行動裝置、消費性電子產品的需求可望逐漸恢復正常。

2 在半導體供應商調節產能及下半年季節性需求增加下，將有利於庫存水位下降，IC封測代工需求有機會回穩。

3 DRAM市況稍有好轉，雖不是全面性回溫，但正慢慢發酵中；市場需求在庫存水位逐漸去化下有機會恢復供需平衡，封測代工需求亦可望逐漸改善。

4

問與答

